

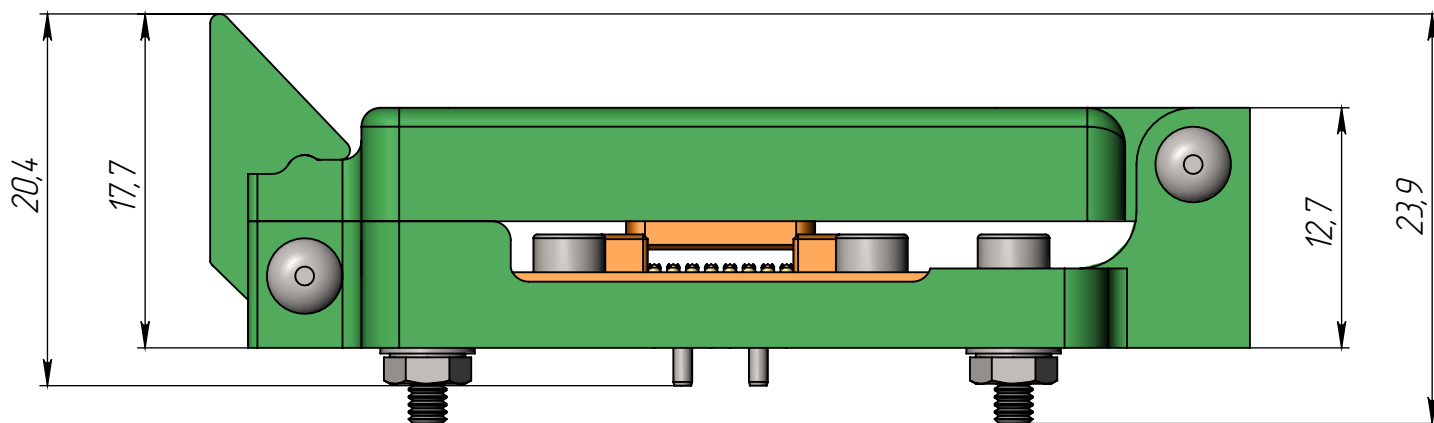
Согласовано

*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.*

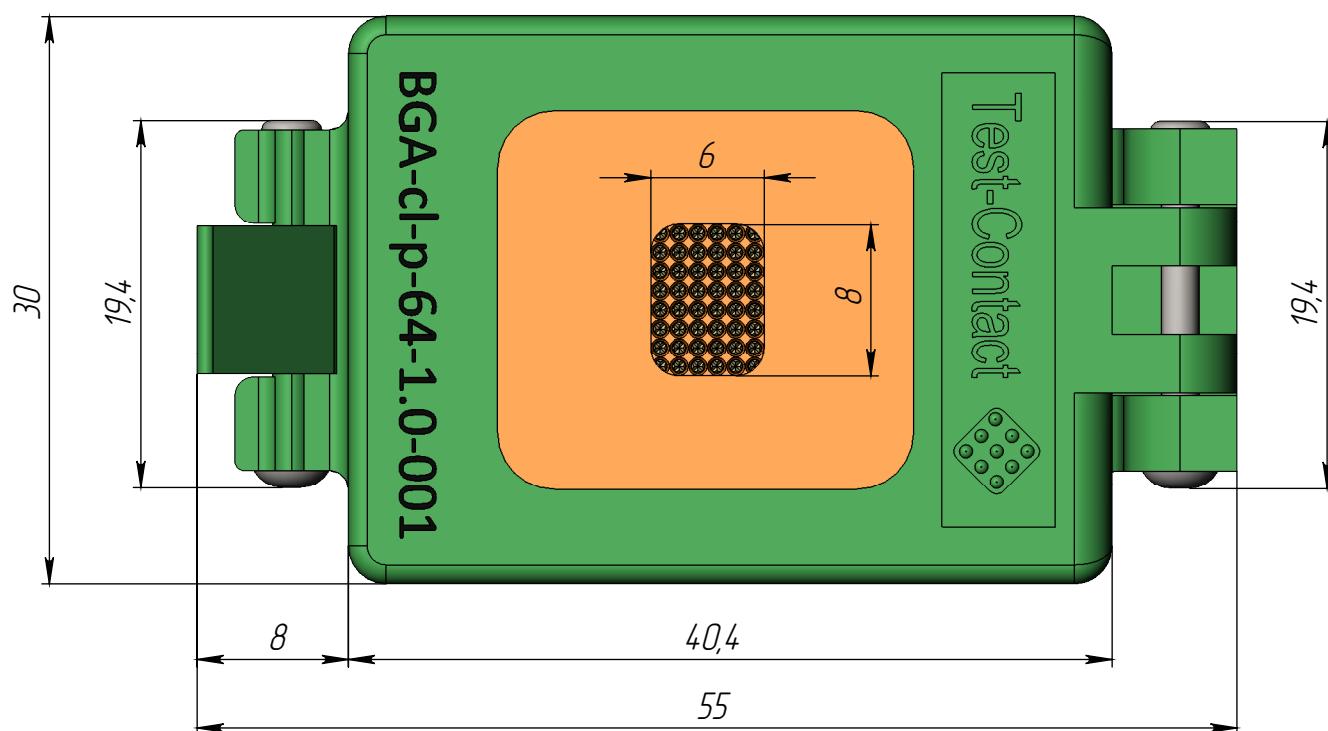
____/____2018г.

____/____2018г.

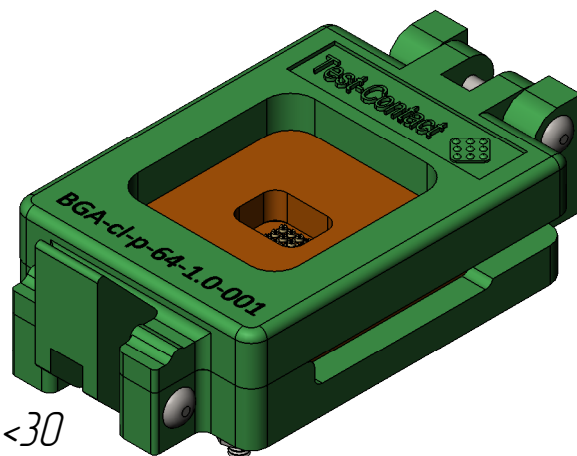
*Паспорт контактирующего устройства
BGA-cl-p-64-1.0-001*



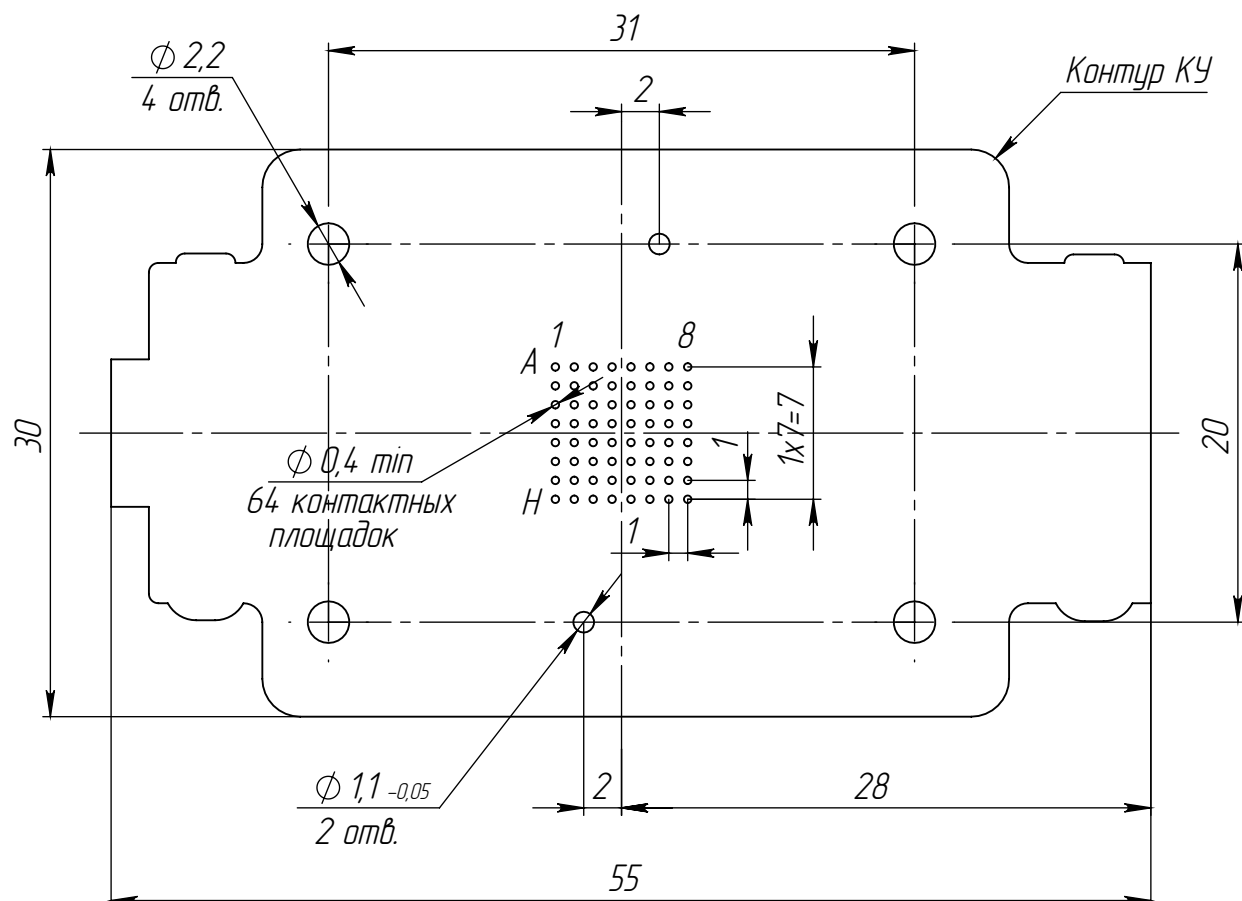
- × Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами М2 (без пайки). Число мест крепления – 4.
- × Базирование КУ относительно платы осуществляется штифтами ϕ 1 мм. Количество штифтов – 2 шт.



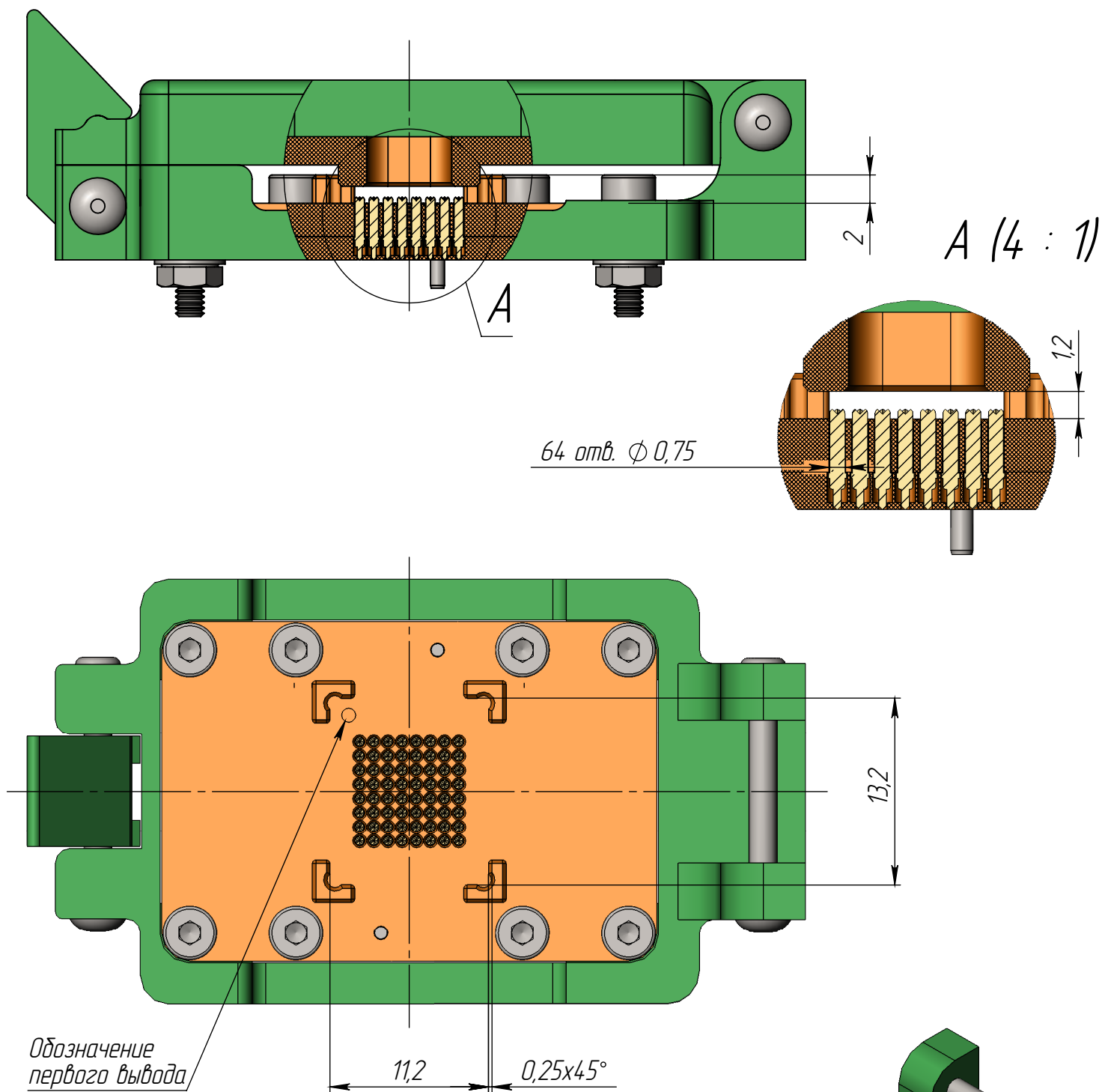
- × Количество ЭРИ, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
- × Количество выводов КУ, шт. – 64
- × Материал КУ (торговая марка) – PEI ULTEM 1000
- × Материал коннекторов – ВeCu
- × Покрытие коннекторов – Au
- × Диапазон рабочих температур, °C –55...+150
- × Максимальный ток на один контакт (НУ), А – 1,0
- × Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <30
- × Гарантированное кол-во контактирований – 10000
- × Ширина полосы, ГГц@ – 3 дБ – >1



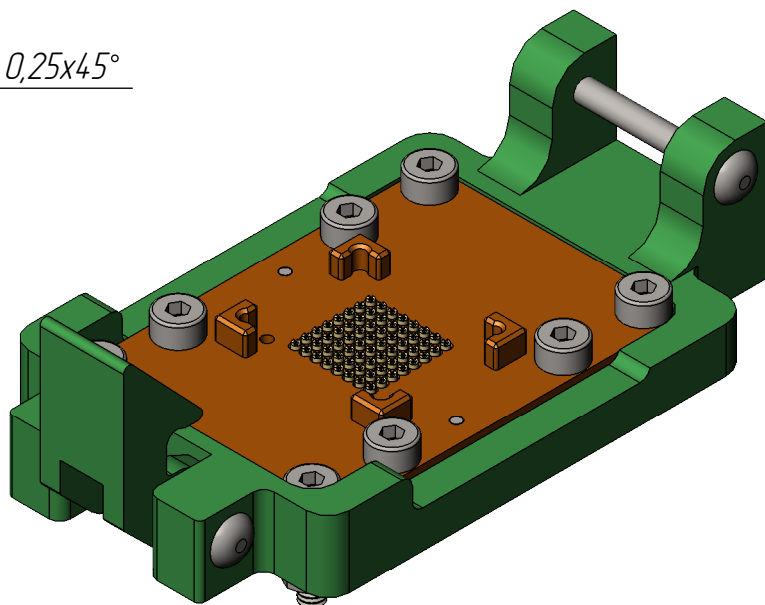
Посадочное место КУ

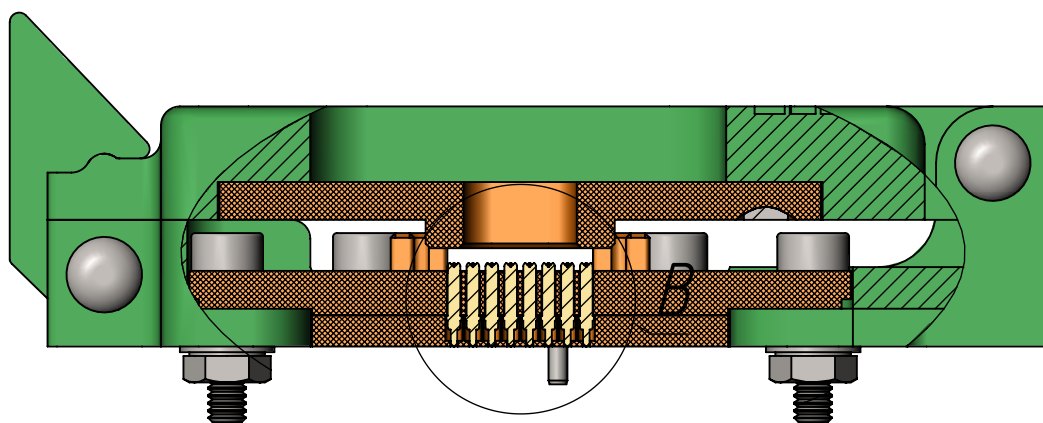
Вид на устройство сверху

1. *Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-тК.

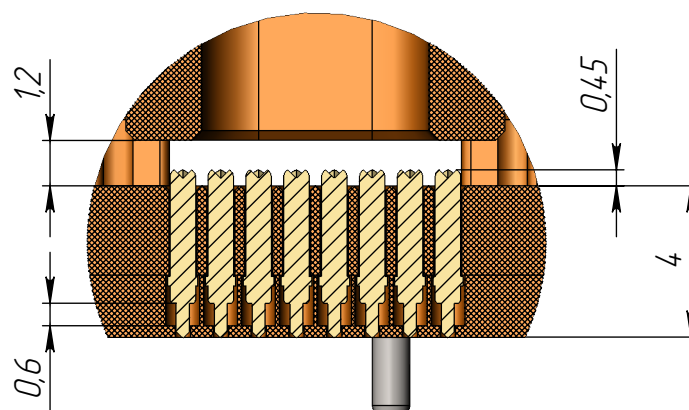


1. *-Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-МК.





B (5 : 1)



1. *-Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-тк.

TOP VIEW

Dimensions: 0.20 C , $2X$, D , E , 1.00 ± 0.5 , $\phi 0.50$, $A1$ CORNER ID. (Bore or Laser).

BOTTOM VIEW

Dimensions: $D1$, $E1$, eD , eE , SD , SE , $A1$ CORNER, $NX \phi b$, $\phi 0.25 \text{ C A B}$, $\phi 0.10 \text{ C}$, $\triangle 6$, $\triangle 7$.

SIDE VIEW

Dimensions: A , $A1$, $A2$, $SEATING \text{ PLANE}$, $\triangle 0.25 \text{ C}$, $\triangle 0.15 \text{ C}$.

PACKAGE	LAA 064			
JEDEC	N/A			
	13.00 mm x 11.00 mm PACKAGE			
SYMBOL	MIN	NOM	MAX	NOTE
A	---	---	1.40	PROFILE HEIGHT
A1	0.40	---	---	STANDOFF
A2	0.60	---	---	BODY THICKNESS
	13.00 BSC.			BODY SIZE
	11.00 BSC.			BODY SIZE
	7.00 BSC.			MATRIX FOOTPRINT
	7.00 BSC.			MATRIX FOOTPRINT
MD	8			MATRIX SIZE D DIRECTION
ME	8			MATRIX SIZE E DIRECTION
N	64			BALL COUNT
øb	0.50	0.60	0.70	BALL DIAMETER
	1.00 BSC.			BALL PITCH - D DIRECTION
	1.00 BSC.			BALL PITCH - E DIRECTION
SD / SE	0.50 BSC.			SOLDER BALL PLACEMENT
	NONE			DEPOPULATED SOLDER BALLS

1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M-1994.
2. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
3. BALL POSITION DESIGNATION PER JESD 95-1, SPP-010 (EXCEPT AS NOTED).
4. e REPRESENTS THE SOLDER BALL GRID PITCH.
5. SYMBOL "MD" IS THE BALL ROW MATRIX SIZE IN THE "D" DIRECTION.
SYMBOL "ME" IS THE BALL COLUMN MATRIX SIZE IN THE "E" DIRECTION.
N IS THE TOTAL NUMBER OF SOLDER BALLS.

B DIMENSION "b" IS MEASURED AT THE MAXIMUM BALL DIAMETER IN A PLANE PARALLEL TO DATUM C.

A SD AND SE ARE MEASURED WITH RESPECT TO DATUMS A AND B AND DEFINE THE POSITION OF THE CENTER SOLDER BALL IN THE OUTER ROW.

WHEN THERE IS AN ODD NUMBER OF SOLDER BALLS IN THE OUTER ROW PARALLEL TO THE D OR E DIMENSION, RESPECTIVELY, SD OR SE = 0.000.

WHEN THERE IS AN EVEN NUMBER OF SOLDER BALLS IN THE OUTER ROW, SD OR SE = e/2

8. NOT USED.
9. "+*" INDICATES THE THEORETICAL CENTER OF DEPOPULATED BALLS

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;*
- производить установку КУ после просушки ПП.*

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне*

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне.*

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.